

СОДЕРЖАНИЕ

Том 42, номер 5, 2013

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Получение тонких пленок поликристаллического кремния путем обработки водородом и отжига при низкой температуре с использованием ICPCVD

А. Ж. Лета, К. Л. Лин, В. К. Иен, Х. Л. Хван

323

Новый сухой метод формирования маскирующего изображения (рельефа) непосредственно в процессе электронно-лучевого экспонирования резиста

М. А. Брук, Е. Н. Жихарев, В. А. Кальнов, А. В. Спирин, Д. Р. Стрельцов

331

Влияние СВЧ плазменной микрообработки в условиях слабой адсорбции на наноморфологию поверхности кристаллов кремния (100)

В. Я. Шаныгин, Р. К. Яфаров

341

Возможности толстых пленок микроэлектроники в создании элементной базы радиоэлектронных систем (обзор)

В. Я. Подвигалкин

348

Покрытия контактных площадок кристаллов и траверс корпусов для микросварки внутренних выводов 3D изделий

В. В. Зенин, А. А. Стоянов, С. В. Петров, Б. А. Спиридонов

361

Электрофизические параметры и концентрации заряженных частиц в плазме метана

*О. А. Семенова, А. М. Ефремов, С. М. Баринов,
А. А. Кучумов, В. И. Светцов*

375

ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

Переключение направленности круговой намагниченности квадратных эпитаксиальных микроструктур Fe (001) спин-поляризованным током

*Л. А. Фомин, И. В. Маликов, К. М. Калач, С. В. Пяткин,
П. Е. Зильберман, Г. М. Михайлов*

383

СХЕМОТЕХНИКА

Использование моделей неполностью определенных булевых функций при синтезе схем по VHDL-описаниям

П. Н. Бибило, А. Л. Соловьев

389